

## 國立臺北科技大學 函

機關地址：106344臺北市大安區忠孝東路  
三段一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：國立成功大學

發文日期：中華民國115年5月20日

發文字號：北科大產學字第1157900113號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：AI整合多物理量數位分身人才培育計畫課程表、AI整合多物理量數位分身人才  
培育計畫課程海報(附件1 115F900362\_1\_20094313296.pdf、附件2  
115F900362\_2\_20094313296.pdf)

主旨：檢送本校與皮托科技股份有限公司合作辦理115年「AI整合多物理量數位分身人才培育計畫」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校在學學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

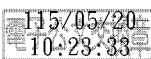
- 一、課程聚焦於半導體產業中AI、數位分身（Digital Twin）與多物理量模擬技術之整合應用，培養具備跨領域分析與實務操作能力之專業人才。課程內容涵蓋半導體元件物理基礎與模擬軟體操作展示，深入探討半導體封裝之電性分析、結構可靠度與壽命特性，並透過半導體製程及電漿設備模擬案例，強化學員對製程參數與設備效能之理解與應用能力。此外，課程亦延伸至半導體元件與封裝之光電特性分析，結合理論、模擬與案例實作，協助學員掌握AI驅動之數位分身技術於半導體設計、製造、封裝與測試領域中的應用趨勢。
- 二、報名資格：全國公私立各大專校院在學學生。
- 三、課程時間：115年6月6日（六）、6月7日（日），共計2天，符合報名資格且全程參與課程者，將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。



- 四、課程地點：國立臺北科技大學行政大樓9樓國際會議廳、Google Meet線上課程。
- 五、人數上限：實體80人/線上200人。(課程免費)
- 六、報名時間：即日起至115年6月1日（一）17時為止（如人數額滿將提前截止）。
- 七、報名網址：<https://forms.gle/fFS1bCVLMG84BVic6>
- 八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6023，電子郵件：[receivable0308@mail.ntut.edu.tw](mailto:receivable0308@mail.ntut.edu.tw)
- 九、本課程由本執辦與皮托科技股份有限公司共同合作辦理。
- 十、檢附115年「AI整合多物理量數位分身人才培育計畫」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學處、皮托科技股份有限公司



# 115 年「AI 整合多物理量數位分身人才培育計畫」課程表

課程日期：115 年 6 月 6 日(六) 和 115 年 6 月 7 日(日)

課程地點：1.北科大行政大樓九樓國際會議廳

2.Google Meet 線上課程

報名資格及人數：全國公私立各大專校院在學學生；實體 80 人及 Google Meet 線上 200 人

課程時間：09:00~18:00(報到時間：08:30~9:00，中午休息時間 12:00~13:00)

報名連結：<https://forms.gle/fFS1bCVLMG84BVic6>

課程內容：



| 日期          | 時間          | 課程名稱                | 課程內容             | 授課教師 | 課程地點                            |
|-------------|-------------|---------------------|------------------|------|---------------------------------|
| 6/6<br>(六)  | 08:30~09:00 | 報 到                 |                  |      | 北科大<br>+Google<br>Meet 線<br>上課程 |
|             | 09:00~12:00 | AI 整合多物理量數位分身人才培育計畫 | 半導體元件物理與軟體操作展示   | 楊棟焜  |                                 |
|             | 13:00~17:00 |                     | 半導體封裝電性與結構壽命特性   |      |                                 |
|             | 17:00~18:00 |                     | 綜 合 討 論          |      |                                 |
|             | 6/7<br>(日)  | 08:30~09:00         | 報 到              |      |                                 |
| 09:00~12:00 |             | AI 整合多物理量數位分身人才培育計畫 | 半導體製程與電漿設備模擬案例探討 | 楊棟焜  |                                 |
| 13:00~17:00 |             |                     | 半導體元件與封裝光電特性分析   |      |                                 |
| 17:00~18:00 |             |                     | 綜 合 討 論          |      |                                 |

備註：

1. 成功提交此表單後即可視為報名成功，您填寫的報名資訊也將寄至您填寫前登入之 Gmail 信箱。
2. 若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名名額資格審核權，以及修改、變更活動內容及額滿截止報名之權利。

# AI整合多物理量 數位分身人才培育計畫



時間：115年6月6日(六)、6月7日(日)

地點：國立臺北科技大學



行政大樓九樓 國際會議廳



主辦單位:教育部產學連結辦公室-國立臺北科技大學  
協辦單位:皮托科技股份有限公司



主辦單位：教育部產學連結辦公室-國立臺北科技大學

協辦單位：皮托科技股份有限公司